

苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司作为全球领先的电子电路研发、设计、生产、销售企业，为进一步巩固和提升行业地位，拓宽高端电子电路产品体系，更好的服务全球优质客户，公司拟投资设立全资子公司专业从事 IC 载板的研发、设计、生产和销售，投资总额不超过人民币 150,000 万元。

（二）董事会审议情况

2021 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立 IC 载板公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外投资不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立 IC 载板公司的基本情况

- 1、公司名称：待定，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准
- 2、投资总额：不超过人民币 150,000 万元
- 3、经营范围：研发、生产、装配和销售新型电子元器件、IC 载板、类载板等（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）
- 4、股本结构：本公司全额出资，持股 100%

5、出资方式：货币出资及实物出资。

三、其他说明

（一）本次对外投资的目的

1、IC 载板市场需求广阔

IC 载板是集成电路产业链封测环节关键载体。随着人工智能、物联网、汽车智能化等新兴技术的推动，叠加第五代通讯技术的不断推广，高性能芯片、5G 基站、5G AiP 模组等电子元件市场应用的持续扩张以及国内 IDM 和晶圆代工厂产能的逐渐释放，封装测试需求将呈高速增长的态势，预计 IC 载板的需求也将随之大幅度提升。IC 载板将持续引领电子电路行业的增长。

2、公司具备实施本次投资的财务能力、技术实力和管理经验

近年来，公司盈利能力和资产规模稳步提升，资本结构持续改善，具备实施本次投资计划的财务能力。公司经过多年的运营，在电子电路领域积累了丰富经验和技術储备。目前公司为全球前三的电子电路企业，服务客户主要为行业知名的消费电子、新能源汽车、通信设备等领域的头部企业。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次投资有利于拓宽公司电子电路产品体系，强化公司在该行业的领先地位和核心竞争力，提升公司的产业规模，更好地服务全球知名客户，提高公司整体盈利水平。预计本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

（三）本次对外投资存在的风险

公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保障对子公司实施有效的管控。另外，或有的外部环境风险、宏观政策风险、行业发展风险等也可能导致投资效益不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日